

# Deutsche Akkreditierungsstelle

## Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-22133-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

**Gültig ab:** 01.07.2023

Ausstellungsdatum: 01.07.2023

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

### **S-Payment**

### **EMVCo- und DK-Prüflabor**

**Am Wallgraben 115, 70565 Stuttgart**

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prüfungen in den Bereichen:

### **Funktionsprüfungen von Chipkarten mit Betriebssystem SECCOS im Prüfgebiet Informationstechnik mit Unterkategorie Smart Cards**

Prüfziele:

#### **Das Prüflabor bietet Prüfungen zur Erlangung einer**

- a. DK Modulzulassung**
- b. EMVCo Card Type Approval**

*Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen ([www.dakks.de](http://www.dakks.de))*

**Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-22133-01-00**

**Innerhalb der angegebenen Prüfbereiche ist dem Prüflaboratorium, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von Prüfverfahren gestattet.**

**Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich.**

**Beschreibung der Prüfziele**

a. Im Rahmen der im DK Zulassungsverfahren sog. „*Funktionstests*“ wird durch das Berichten des Prüfvorgangs „*DK Testsuite 1*“ eine „*DK Modulzulassung*“ erlangt und von der DK Zulassungsstelle erteilt.

**Prüfverfahren zum Prüfvorgang „DK Testsuite 1“:**

Titel des Prüfverfahrens	Version des Prüfverfahrens	Beschreibung des Prüfverfahrens	Anforderungen an den Prüfgegenstand
DK Testsuite 1 – Software Tests	2.2	<p>Gemäß DK Anforderungen werden Tests über die kontaktbehaftete und ggf. kontaktlose Schnittstelle durchgeführt. Umfang der Tests sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard- und Ergänzungskommandos und Kommandoübergreifende Tests</li> <li>• Test der bidirektionalen kontaktbehafteten Schnittstelle der Chipkarte mit dem Übertragungsprotokoll T=1</li> <li>• Test der bidirektionalen kontaktlosen Schnittstelle der Chipkarte mit dem Übertragungsprotokoll T=CL</li> <li>• Test eines konsistenten Datenzustands bei einem Kommunikationsabbruch mit dem Terminal</li> </ul>	Der Prüfgegenstand ist nach DK Schnittstellenspezifikationen des Betriebssystems umgesetzt.

**Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-22133-01-00**

b. Im Rahmen der im EMVCo Zulassungsverfahren sog. „Card Functional Evaluation“ wird durch das Berichten der Prüfvorgänge „EMVCo Level 1 electrical and Protocol Testing“ und „EMVCo Level 2 CPA/CCD Testing“ eine „EMVCo Card Type Approval“ erlangt und von der EMVCo Zulassungsstelle erteilt.

**Prüfverfahren zum Prüfvorgang „EMVCo Level 1 electrical and Protocol Testing“ und „EMVCo Level 2 CPA/CCD Testing“:**

<b>Titel des Prüfverfahrens</b>	<b>Version des Prüfverfahrens</b>	<b>Beschreibung des Prüfverfahrens</b>	<b>Anforderungen an den Prüfgegenstand</b>
EMVCo Level 1 – electrical Testing	2.0	Gemäß EMV Anforderungen werden kontaktbehaftete Tests der elektrischen Eigenschaften der Chipkarte bei vorgegebenen Klimawerten (Temperatur, Luftfeuchte) durchgeführt.	Der Prüfgegenstand ist nach DK Schnittstellenspezifikationen des Betriebssystems und nach EMV Books 1 bis 4 inkl. Specification Bulletins umgesetzt und unterstützt die kontaktbehaftete Schnittstelle.
EMVCo Level 1 - Protocol Testing	2.0	Gemäß EMV Anforderungen werden Tests der bidirektionalen kontaktbehafteten Schnittstelle der Chipkarte mit dem Übertragungsprotokoll T=1 bei vorgegebenen Klimawerten (Temperatur, Luftfeuchte) durchgeführt.	Der Prüfgegenstand ist nach DK Schnittstellenspezifikationen des Betriebssystems und nach EMV Books 1 bis 4 inkl. Specification Bulletins umgesetzt und unterstützt die kontaktbehaftete Schnittstelle.
EMVCo Level 2 CPA/CCD Testing	2.1	Gemäß EMV Anforderungen werden kontaktbehaftete CPA/CCD Tests von Standard- und Ergänzungscommandos und Kommandoübergreifende Tests durchgeführt.	Der Prüfgegenstand ist nach DK Schnittstellenspezifikationen des Betriebssystems und nach EMV Books 1 bis 4 inkl. Specification Bulletins umgesetzt und unterstützt die kontaktbehaftete Schnittstelle.

**Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-22133-01-00**

**Verwendete Abkürzungen:**

DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
EN	Europäische Norm
IEC	International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO	International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung
CCD	Common Core Definition
CPA	Common Payment Application
DK	Die Deutsche Kreditwirtschaft
EMV	Eine Spezifikation für Zahlungskarten der drei namensgebenden Gesellschaften Europay (jetzt MasterCard Europe), MasterCard und Visa.
SECCOS	Secure Chip Card Operating System
ZKA	Zentraler Kreditausschuss (wurde namentlich durch DK ersetzt)

**Definitionen:**

DK	Die Deutsche Kreditwirtschaft vertritt die Interessen der kreditwirtschaftlichen Spitzenverbände in Deutschland, siehe <a href="http://www.die-dk.de">www.die-dk.de</a> .
EMVCo	EMVCo ist eine Evaluierungseinrichtung, welche von diversen internationalen Payment Systems gegründet wurde und gemeinsam betrieben wird, siehe <a href="http://www.emvco.com">www.emvco.com</a> .